

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成20年10月30日 (2008.10.30)

【公開番号】特開2007-88394(P2007-88394A)  
 【公開日】平成19年4月5日 (2007.4.5)  
 【年通号数】公開・登録公報2007-013  
 【出願番号】特願2005-278771(P2005-278771)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

C 2 3 C 16/52 (2006.01)

C 2 3 C 16/46 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/205

C 2 3 C 16/52

C 2 3 C 16/46

【手続補正書】

【提出日】平成20年9月10日 (2008.9.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板を処理する処理室と、

該処理室を加熱する加熱手段と、

前記処理室外に配置され前記加熱手段の温度を測定する第 1 の温度センサと、

該第 1 の温度センサよりも前記基板近傍に配置され前記処理室内の温度を測定する第 2 の温度センサと、

前記第 1 及び第 2 の温度センサでそれぞれの測定する温度に基づき前記加熱手段を制御する制御手段とを備え、

前記制御手段は、

前記処理室内で設定温度にて基板を処理するよう前記加熱手段を制御している際に、前記第 2 の温度センサが正常に温度測定できなくなったとき、前記第 2 の温度センサが正常に温度測定できなくなる前に求めて記憶しておいた前記設定温度にて温度が安定した際の前記第 1 及び第 2 の温度センサで測定したそれぞれの温度の温度差を、前記第 2 の温度センサで測定する温度と前記設定温度との偏差に基づき第 1 の演算をすることに替えて、前記記憶された温度差により前記設定温度を補正し、該補正結果と前記第 1 の温度センサで測定する温度との偏差に基づき第 2 の演算を行い、該第 2 の演算結果に基づき前記加熱手段を制御することを特徴とする基板処理装置。

【請求項 2】

処理室内で設定温度にて基板を処理するよう、加熱手段の温度を測定する第 1 の温度センサの測定する温度と該第 1 の温度センサよりも前記基板近傍に配置され前記処理室内の温度を測定する第 2 の温度センサの測定する温度に基づき前記加熱手段を制御している際に、前記第 2 の温度センサが正常に温度測定できなくなったとき、該第 2 の温度センサが正常に温度測定できなくなる前に予め求めて記憶しておいた前記設定温度にて温度が安定した際の前記第 1 及び第 2 の温度センサで測定したそれぞれの温度の温度差を、前記第 2 の温度センサで測定する温度と前記設定温度との偏差に基づき第 1 の演算をすることに替え

て、前記記憶された温度差により前記設定温度を補正し、該補正結果と前記第 1 の温度センサで測定する温度との偏差に基づき第 2 の演算を行い、該第 2 の演算結果に基づき前記加熱手段を制御することを特徴とする半導体装置の製造方法。